



全球半导体行业周报

存储成为全行业产能的定价者：加息与规则空窗下的板块重新分层

发布主体：百思特变革研究院半导体智库 | 期次日期：2026-09-22 | 覆盖窗口：2026-09-14 至 2026-09-20

本期总判断

本周半导体行业的约束条件从算力供给转向存储供给，资本市场按能否拿到存储重新给企业分层，而规则层面连续第二周没有产出。

一、存储从成本项变为产能项。 64GB DDR5 服务器模组合约价升至 1,500 美元、约为上年同期 272 美元的 5.5 倍；Intel 首席执行官 9 月 15 日表示内存价格已上涨 5 至 7 倍且会更糟，多个项目因拿不到内存延期；苹果接受三星 2027 年一季度涨价 30%—40%。

二、资本市场按存储敞口分层。 SanDisk 周涨 9.70%、AMD 涨 8.46%、Intel 涨 5.50%、Micron 涨 4.16%，而 Lam Research 跌 3.39%、应用材料跌 2.61%、KLA 跌 2.02%；设备三家距 6 月高点回撤 33%—41%，深于费城半导体指数的 18.5%。

三、加息而板块收涨。 9 月 16 日美方加息 25 个基点至 3.75%—4.00%，为 2023 年 7 月以来首次；同周费城半导体指数仍涨 0.83% 至 11,921.69，定价依据已从利率转向订单可见度。

四、规则层面连续第二周空窗。 联邦公报本周无新的半导体出口限制规则，半导体关税第二阶段的税率与生效日仍未公布；11 月 9 日至 10 日三项时限集中到期。

五、中国产业链与美股背离。 昇腾 960 超节点 9 月 17 日发布，单节点 4,096 卡、8 EFLOPS、1PB 高带宽存储；9 月 18 日 A 股成交 2.08 万亿元，科创 50 周涨 6.39%、半导体 ETF 周涨 8.44%。

六、需要跟踪的关键变量： 9 月 30 日 Micron 四季度合约价指引、关税配额资格、关税第二阶段公布时点、设备企业 2028 年订单可见度口径、国产加速器在存储配额下的实际出货。

目录

本周概览.....3

一、本周要点.....7

二、重大事件及其影响.....8

三、行业景气与资本市场.....9

四、存储周期与装备制造链.....10

五、政策、贸易与供应链安全.....12

六、重点企业动态.....13

七、中国半导体产业链.....14

八、行业会议与人物观点.....15

九、趋势判断.....16

十、主要风险与下周关注事项.....16

十一、管理观察与行动建议.....18

数据来源与口径.....20

阅读导引：企业决策层建议优先阅读"本周要点""重大事件及其影响""趋势判断"与"管理观察与行动建议";

产业研究人员建议重点阅读"行业景气与资本市场""存储周期与装备制造链"与"重点企业动态"; 政策与资

本市场研究人员建议重点阅读"政策、贸易与供应链安全""中国半导体产业链"与"主要风险与下周关注事

项"。

本周概览

关键指标

全球半导体月销售额（7月，SIA） 1,468 亿美元 同比 +135.1%，环比 +6.4% 三个月移动平均，连续 17 个月环比增长	日本制半导体设备销售额（8月） 5,979 亿日元 同比 +47.4%，环比 +7.5% 三个月移动平均速报值，9月18日发布	韩国半导体出口（9月1—20日） 341.28 亿美元 同比 +259.4% 占整体出口 47.8%，较上年同期提高 24.1 个百分点
费城半导体指数（9月18日） 11,921.69 周 +0.83% 9月14日单日 -5.9%，距6月峰值 -18.5%	科创 50 指数（9月18日） 1,652.63 周 +6.39% 半导体 ETF（512480）周 +8.44%	DDR5 16Gb 现货价（9月21日） 56.933 美元 日 +1.67% DDR4 16Gb 报 85.000 美元，出现价格倒挂
64GB DDR5 服务器模组合约价 1,500 美元 约为上年同期 5.5 倍 上年同期 272 美元	昇腾 960 超节点互联规模 4,096 张加速卡 上一代为 1,024 张 FP8 算力 8 EFLOPS，HBM 容量 1PB	联邦基金利率目标区间（9月16日） 3.75%—4.00% 加息 25 个基点 2023 年 7 月以来首次加息

一周大事记（2026 年 9 月 14 日至 9 月 20 日）

9 月 14 日 周一	■ 两家主要人工智能企业负责人公开主张放慢模型能力提升速度，存储股领跌，Micron 与 SanDisk 盘中均跌约 6%，费城半导体指数当日下跌 5.9% 至 11,131.28 ■ 铠侠考虑以美国存托股上市募资最高 100 亿美元，其东京上市股年内涨近 400%、市值约 1,830 亿美元 ■ 供应链消息称台积电 2nm 产能将由 2026 年底 9 万片/月增至 2027 年中 11 万片/月、3nm 由逾 18 万片/月增至 21 万片/月，CoWoS 由 2026 年底约 13 万片/月翻倍至 2028 年底 26 万片/月 ■ TrendForce 称大容量 NOR Flash 潜在涨价 90%—110% ■ 粤芯半导体披露创业板发行安排，拟募资 75 亿元 ■ 科创 50 指数下跌 1.62%
-----------------------------------	--

9月15日

周二

- 中国印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》，提出到 2030 年规模以上企业营业收入突破 30 万亿元、研发投入强度 3.5%，推动集成电路全链条攻关列 17 项重点任务之首
- 联发科发布首款 2nm 智能手机处理器天玑 9600 Pro，采用台积电 2nm 制程
- Intel 首席执行官表示内存价格已上涨 5 至 7 倍、情况会更糟，多个项目因拿不到内存延期
- 地平线宣布征程系列累计量产突破 1,500 万套，上半年中国全阶智能驾驶芯片市占 31.94% 居首
- 科创 50 指数上涨 1.55%

9月16日

周三

- 美方加息 25 个基点，联邦基金利率目标区间升至 3.75%—4.00%，为 2023 年 7 月以来首次
- 路透报道 SK 海力士与 Intel 就在美国本土生产存储芯片进行探索性谈判，路径包括租用俄亥俄州晶圆厂部分产能或组建合资公司，Intel 盘前涨 5.2%、SK 海力士首尔收盘涨 4.1%，SK 海力士随后澄清未敲定任何计划
- IBM 旗下 Anderon 获得 10 亿美元芯片法案资助用于量子晶圆制造研发，IBM 另行投入 10 亿美元
- TrendForce 称 2026 年全球数据中心用电需求容量同比增长 31% 至 161GW
- Gartner 预计 2026 年全球人工智能支出增长 49.5%
- 信诺维科创板上市，首日收涨 45.58%
- 科创 50 指数上涨 4.14%

9月17日

周四

- 华为全联接大会 2026 在上海开幕，发布昇腾 960 超节点，单节点互联 4,096 张加速卡（上一代 1,024 张）、FP8 算力 8 EFLOPS、HBM 总容量 1PB，以 5,500 个自研光引擎替代约 4.8 万个 800G 光模块，系统功耗降低超 550 千瓦
- 昇腾 960DT 提前三个季度至 2027 年一季度就绪
- 印度 Semicon India 2026 开幕并推出第二阶段半导体方案，拨款 135 亿美元、一期 80 亿美元，已批准 12 个项目、总投资超 1.64 万亿卢比
- 应用材料公布印度计划，至 2035 年投资 50 亿美元
- 英伟达首席执行官表示明年公司芯片销量将是今年的两倍
- 日美正就在 5,500 亿美元投资框架下新建一座由格罗方德运营的半导体工厂进行磋商，规模 2 万亿—3 万亿日元
- 费城半导体指数上涨 3.14%

9月18日
周五

- 日本半导体制造装置协会发布 8 月日本制设备销售额 5,979.15 亿日元，环比增长 7.5%、同比增长 47.4%，同期平板显示设备同比下降 20.9%
- 高盛重申三星电子买入并列入 Conviction Buy 名单、目标价上调至 49 万韩元，三星管理层表示 2027 年供需将比 2026 年更紧
- 软银将以 Arm 股票质押的保证金贷款额度增加 50 亿美元至 250 亿美元
- 华卓精科技露科创板首轮审核问询函回复，拟募资约 35 亿元
- 美股存储板块大涨，SanDisk 涨 10.99%、Micron 涨 3.92%，费城半导体指数收涨 2.78% 至 11,921.69
- A 股放量 2.08 万亿元普涨，科创 50 涨 2.88%、周涨 6.39%，申万半导体指数涨 3.97%，芯片概念主力资金净流入 362 亿元居全市场首位

9月19日
周六

- 华为全联接大会闭幕
- 印度 Semicon India 第二日再签 25 项合作，印方称第一阶段批准的 12 个项目中已有 5 个开始商业量产

9月20日
周日

- 中美经贸团队在纽约开始磋商，会谈持续约 8 小时，双方讨论落实非战略性商品相互降税的识别流程，前瞻规模约 300 亿美元
- 韩国进出口银行海外经济研究所将 2026 年全球半导体市场规模预测上调至 1.6 万亿美元，较一个季度前上调 60%，2030 年展望上调至 2 万亿美元，存储占比由约 30% 升至 55%，全球九大超大规模云厂商今年资本开支同比增长 98%
- 海光信息预告 9 月 22 日发布 1000 系列处理器
- 2026 世界制造业大会在合肥开幕

一周图表

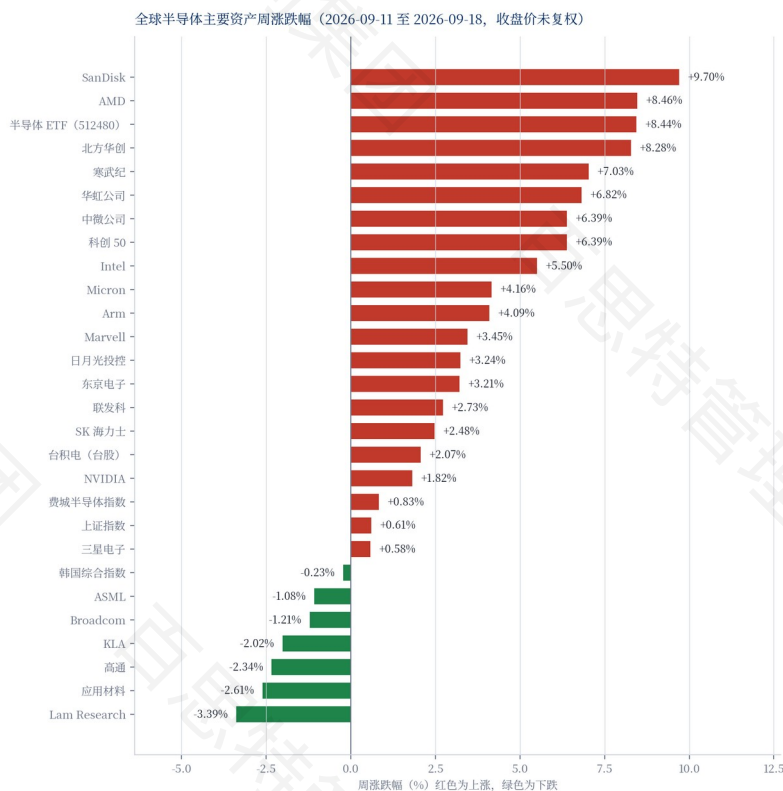


图1 全球半导体主要资产周涨跌幅（2026-09-11至2026-09-18，收盘价未复权；数据来源：Yahoo Finance、腾讯行情）



图2 日本制半导体制造装置月度销售额与同比（三个月移动平均；数据来源：日本半导体制造装置协会，2026年9月18日发布）

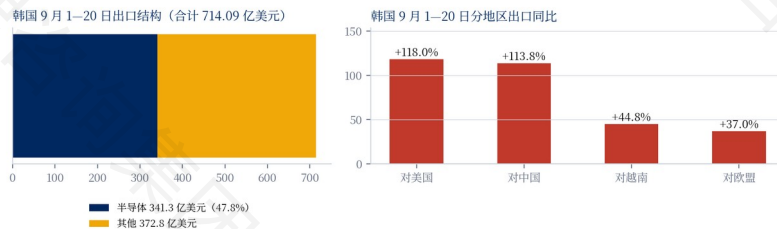


图3 韩国9月1—20日出口结构与分地区出口同比（数据来源：韩国关税厅）

一、本周要点

- **存储价格进入决定交付能力的区间。** 64GB DDR5 服务器模组合约价升至 1,500 美元，上年同期 272 美元，约为 5.5 倍；DDR5 16Gb 现货价 9 月 21 日报 56.933 美元，DDR4 16Gb 报 85.000 美元，出现新旧制程价格倒挂，原因是 DDR4 产能收缩快于需求退出。
- **主要处理器企业首次公开承认内存是项目延期原因。** Intel 首席执行官 9 月 15 日表示内存价格已上涨 5 至 7 倍，多个项目因拿不到内存而延期。这是本轮存储周期中第一条来自系统厂商的交付端表态此前口径多停留在成本端。
- **终端厂商已接受 2027 年继续涨价。** 苹果接受三星 2027 年一季度 DRAM 与 NAND 较 2026 年三季度上涨 30%—40% 的报价，2027 年智能手机的物料成本下限被提前锁定。
- **资本市场按存储敞口重新分层。** 本周 SanDisk 涨 9.70%、AMD 涨 8.46%、Intel 涨 5.50%、Micron 涨 4.16%；同期 Lam Research 跌 3.39%、应用材料跌 2.61%、KLA 跌 2.02%。设备三家距 6 月高点回撤 33%—41%，深于费城半导体指数的 18.5%。
- **加息未改变板块方向。** 9 月 16 日美方加息 25 个基点至 3.75%—4.00%，为 2023 年 7 月以来首次；美债 10 年期收益率周内升 2.3 个基点至 4.998%，费城半导体指数同周仍涨 0.83%。
- **日本设备出口增速连续六个月加速。** 8 月日本制半导体制造装置销售额 5,979.15 亿日元、同比增长 47.4%，同比增速自 3 月的 11.1% 连续六个月上行；同期平板显示设备同比下降 20.9%，景气高度集中于半导体前道。
- **存储制造首次出现跨洲产能借用的可能。** SK 海力士与 Intel 就在美国本土生产存储芯片进行探索性谈判，方案包括租用俄亥俄州晶圆厂部分产能；若成立将是韩系存储企业首次在美制造。
- **规则层面连续第二周无产出。** 联邦公报 9 月 14 日至 20 日无新的半导体出口限制规则，半导体关税第二阶段未公布，企业合规调整窗口延长。
- **国产加速器以系统规模应对单卡差距。** 昇腾 960 超节点单节点互联 4,096 张加速卡，为上一代的 4 倍，FP8 算力 8 EFLOPS、HBM 容量 1PB，并以 5,500 个自研光引擎替代约 4.8 万个 800G 光模块，系统功耗降低超 550 千瓦。

- 中国与美国半导体资产本周走势背离。9月18日A股成交2.08万亿元，科创50周涨6.39%、半导体ETF周涨8.44%，而同期费城半导体指数仅涨0.83%，不应以同一口径描述两地板块。

二、重大事件及其影响

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
64GB DDR5 服务器模组合约价升至1,500美元，上年同期272美元	存储	服务器物料成本结构改变，存储占整机成本比重上升；云厂商单位算力资本开支抬高，对自研加速器的成本优势形成稀释	行业媒体综合，可信度中高
Intel 首席执行官称内存价格上涨5至7倍、多个项目因缺存储延期	系统与整机	系统厂商交付节奏受存储配额约束，订单能否转化为收入取决于存储采购能力；服务器整机交付周期延长	论坛现场，可信度高
苹果接受三星2027年一季度存储涨价30%—40%	存储与终端	2027年智能手机物料成本下限被锁定，终端厂商毛利率承压或转嫁售价；中低容量机型配置可能下调	行业媒体，可信度中高
美方加息25个基点至3.75%—4.00%	宏观	融资成本上升抬高数据中心建设的资金门槛，对现金流为负的算力租赁企业影响最大；美债10年期升至4.998%	货币政策公告原文，可信度高
SK海力士与Intel就在美生产存储进行探索性谈判	存储与制造	若成立，韩系存储企业首次在美制造，Intel俄亥俄产能利用率提升	路透独家，公司澄清未定，可信度中
日本制半导体设备8月销售额5,979.15亿日元、同比+47.4%	装备制造	日本设备商在手订单转化速度快于市场预期，与设备股股价背离；同比增速连续六个月加速	行业协会原文，可信度高
昇腾960超节点发布，单节点4,096卡、8EFLOPS、1PB HBM	中国加速器	以系统规模弥补单卡差距，对国产光互连形成替代拉动；产品就绪时点提前三个季度	厂商发布会，可信度高
台积电2nm产能2027年中增至11万片/月、CoWoS 2028年底翻倍至26万片/月	制造与封装	先进封装瓶颈在2028年前后缓解，2027年仍为紧供给；设备与材料企业订单能见度延伸至2028年	供应链消息经媒体转述，可信度中
印度推出第二阶段半导	政策	已批12个项目、5个进入商业量产，封测环节为	官方发布，可信度高

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
体方案，拨款 135 亿美元		主；对全球封测产能地理分布形成中期分流	

三、行业景气与资本市场

7 月全球半导体销售额 1,468 亿美元、同比增长 135.1%，8 月日本制设备销售额同比增长 47.4%，两项数据同时处于统计序列高位，而价格是主要驱动。中国 8 月集成电路进口数量同比增长 6.72%，金额同比增长 74.32%，两者相差 67.6 个百分点，晶圆的物理流动没有同步放大，增量几乎全部来自单价。同一结论在韩国数据中也成立：8 月计算机产品出口 62.4 亿美元、同比增长 419.5%，主因是固态硬盘与模组的价格转嫁而非出货量扩张。SIA 的 135.1% 同比亦建立在上年同期 625 亿美元的低基数之上，引用时须同时给出基数。

设备景气在日本厂商侧最为集中。二季度日本市场为唯一同比负增长的地区（24.4 亿美元、同比 -9%），而日本厂商全球销售同比增长 47.4%，增量来自向韩国、台湾与北美的出口。同期欧洲设备出货同比增长 70%、韩国增长 54%，是两个引擎；中国同比仅增长 5%，但仍连续 13 个季度为全球最大设备市场。

指标	最新值	同比	说明
全球半导体销售额（7 月，SIA）	1,468 亿美元	+135.1%	环比 +6.4%，三个月移动平均口径，连续 17 个月环比增长；上年同期基数 625 亿美元
全球半导体设备出货（二季度）	405.3 亿美元	+23%	环比 +11%，连续两季创纪录；中国 119.1 亿美元、台湾 108.9 亿美元、韩国 90.8 亿美元
日本制半导体设备销售（8 月）	5,979.15 亿日元	+47.4%	环比 +7.5%，三个月移动平均速报值；同比增速自 3 月的 11.1% 连续六个月上行
韩国出口（9 月 1—20 日）	714.09 亿美元	+78.3%	同期历史最高；日均出口同比 +89.8%
韩国半导体出口（9 月 1—20 日）	341.28 亿美元	+259.4%	占整体出口 47.8%，较上年同期提高 24.1 个百分点

指标	最新值	同比	说明
台湾出口（8月）	824.0 亿美元	+41.0%	单月新高，连续第 34 个月正增长；电子零组件 322.2 亿美元、同比 +58%
台积电合并营收（8月）	5,148.1 亿新台币	+53.3%	环比 +10.1%；1—8 月累计 33,868.7 亿新台币、同比 +39.3%
全球半导体营收（二季度，Omdia）	4,250 亿美元	环比 +31.4%	创纪录，该机构预计三季度突破 5,000 亿美元

资本市场方面，费城半导体指数周涨 0.83% 至 11,921.69，年内上涨 68.3%，距 6 月 22 日峰值 14,634.72 回撤 18.5%；台湾加权指数周涨 2.16% 至 47,180.75，距一年高点仅 1.2%；韩国综合指数周跌 0.23%，距一年高点回撤 24.4%；科创 50 指数周涨 6.39% 至 1,652.63，滚动市盈率 135.83 倍；恒生科技指数周涨 1.97%。本周定价结构有三个特征。第一，存储与加速器上行、设备下行，说明市场在为当期价格弹性支付溢价，而对未来资本开支强度打折；设备三家距 6 月高点回撤 33%—41% 与费城半导体指数 18.5% 之间的价差，本身即是对 2027 年资本开支增速放缓的定价。第二，台积电与台湾加权指数分别距一年高点仅 2.0% 与 1.2%，是全球半导体资产中唯一接近前高的一组，原因在于其收入结构同时覆盖先进逻辑与先进封装，受存储价格冲击最小。第三，A 股与美股背离：9 月 18 日 A 股成交 2.08 万亿元、较前一日放量 2,539.66 亿元，涨跌家数 4,234 比 1,152，芯片概念主力资金净流入 362 亿元、存储芯片 188 亿元、数据中心 186 亿元，包揽全市场前三，而同期美股半导体接近持平。

融资与并购方面，本周资金集中在互连与内存架构环节：Cornelis 完成 2.05 亿美元融资并与高通达成合作，Euclid 约 2.31 亿美元，Delos Data 超 1 亿美元，Polaris Electro-Optics 5,000 万美元，TeRAM 3,700 万美元。并购方面，英飞凌将 NOR Flash 与铁电存储业务以 11.2 亿美元现金出售给华邦电子，预计 2027 年下半年完成。

四、存储周期与装备制造链

本周存储主线的性质发生改变：此前存储涨价影响的是整机成本，本周开始影响整机能否交付。9 月 21 日现货报价中，DDR5 16Gb 均价 56.933 美元，DDR4 16Gb 均价 85.000 美元，DDR4 8Gb 均价 46.036 美元，NAND 512Gb TLC 晶圆 20.083 美元。DDR4 16Gb 价格高于 DDR5 16Gb，是本轮周期中首次出

现的新旧制程倒挂，原因是主要厂商将 DDR4 产能转向 DDR5 与高带宽存储，供给退出速度快于工业、网络设备等长尾需求的退出速度。高带宽存储对晶圆产能的占用系数远高于常规 DRAM：昇腾 960 超节点单节点 HBM 容量 1PB、单卡 288GB、带宽 9.6TB/s，这一量级的配置在全球范围内复制，直接压缩常规服务器内存的晶圆供给。Micron 本周发布全球首款 512GB DDR5 服务器内存模组，以硅通孔垂直堆叠实现超高密度，是在单位晶圆面积受限条件下提高单模组容量的技术路径，而非产能扩张。

传导已出现在三个层面。终端定价层面，苹果接受三星 2027 年一季度涨价 30%—40%；终端配置层面，个人电脑与手机品牌开始减产并采用替代内存方案，存储成本上升正在推迟人工智能终端设备的容量升级；交付节奏层面，系统厂商已公开表示多个项目因拿不到内存延期。中国人工智能芯片厂商因高带宽存储成本上涨已集体上调报价，涨幅区间 20%—50%，原因是缺少与存储厂商的长期协议，采购更依赖现货与短约。本刊判断，存储紧张在 2027 年内不会自行缓解，理由有三条：高带宽存储对晶圆产能的挤占系数在 HBM4 世代继续上升；主要厂商的扩产投入周期设定在 2028 年至 2032 年，铠侠与 SanDisk 在日本的投资期即至 2032 年；传统 DRAM 的供给退出已经发生且不可逆。可能改变这一判断的情形有两种：云厂商实际下调资本开支且幅度超过 15%，或四季度合约价指引涨幅低于 5%。

装备制造链本周的核心特征是订单与估值背离。ASML 表示极紫外光刻系统订单已排满至 2027 年，Lam Research 表示芯片需求根本上已售罄，日本制设备 8 月销售同比增长 47.4% 且增速连续六个月上行；而应用材料、Lam Research、KLA 本周分别下跌 2.61%、3.39%、2.02%，距 6 月高点回撤 33%—41%，东京电子与 DISCO 距高点回撤 32.6% 与 40.8%。这一背离的合理解释是：市场认为 2027 年是本轮资本开支的高点，2028 年增速将回落，而设备股定价的是增速的变化率而非绝对水平。台积电 2026 年资本开支指引 600 亿—640 亿美元，其中 70%—80% 投向先进制程，并在台湾、亚利桑那、日本新增三座 3nm 厂；存储侧三星称产能扩张优先给 DRAM 与高带宽存储。这些口径共同支撑 2027 年设备需求但 2028 年之后的增量尚无对应承诺。判断当前回撤是估值修正还是真实预期，应观察设备企业四季度财报中滚动需求预测的期间长度是否收窄、2028 年金额是否低于 2027 年，而非观察在手订单总额。

五、政策、贸易与供应链安全

联邦公报 9 月 14 日至 20 日无新的半导体出口限制规则，亦无相关管制清单变更，规则层面连续第二周空窗。半导体关税第二阶段本周无官方进展：第一阶段自 2026 年 1 月 15 日起生效、税率 25%；美方此前确认第二阶段采用在美生产免税、不在美生产付费的原则并配套关税抵扣计划，但税率、产品清单与生效日均未公告。网络流传的 9 月 29 日生效等日期无对应官方文本，不予采信。先进制造投资税收抵免的抵免率为 25%，项目必须在 2026 年 12 月 31 日前开工方可享受，距今约 100 天，是四季度美国本土晶圆厂投资决策的硬约束。本周芯片法案项下唯一新公告是 IBM 旗下 Anderon 获得 10 亿美元奖项，用于纽约 Albany 的量子晶圆制造研发，IBM 另行投入 10 亿美元。中美经贸磋商于 9 月 20 日在纽约举行，会谈持续约 8 小时，双方讨论落实非战略性商品相互降税的识别流程，前瞻规模约 300 亿美元，关键矿产议题未取得新进展。需要提示的时间点是：关税休战、关联方认定规则暂停期与关键矿产管制暂停期三项时限在 11 月 9 日至 10 日的同一窗口内到期，构成四季度最集中的规则风险。

亚洲与欧洲的产业政策本周是主要增量。中国 9 月 15 日印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》，提出到 2030 年规模以上企业营业收入突破 30 万亿元、研发投入强度 3.5%，推动集成电路全链条攻关列 17 项重点任务之首，明确发展高性能处理器、高密度存储器、高可靠性模拟及数模混合芯片，推动氧化镓金刚石等超宽禁带半导体产业化并推进三维集成。印度 9 月 17 日至 19 日举办 Semicon India 2026 并推出第二阶段半导体方案，拨款 135 亿美元、一期 80 亿美元，已批准 12 个项目、总投资超 1.64 万亿卢比构成为 1 个硅晶圆厂、1 个碳化硅晶圆厂、1 个氮化镓微发光二极管显示厂与 9 个封测厂，第一阶段 12 个项目中已有 5 个开始商业量产；展会首日获投资承诺约 1 万亿卢比并签署 16 项合作，第二日再签 25 项。日美正就在 5,500 亿美元投资框架下新建一座由格罗方德运营的半导体工厂进行磋商，规模 2 万亿—3 万亿日元（128.5 亿—192.7 亿美元），为该投资框架首次明确指向半导体制造资产。欧盟方面，9 月 24 日将就第二阶段芯片法案举行政策辩论，首部芯片法案累计撬动公私投资逾 530 亿欧元、建成 5 条中试线，2025 年欧盟半导体消费 411 亿欧元、占全球出货 10.5%，第二阶段目标达成一致的时点为 2027 年二季度；欧盟网络韧性法案的报告义务 9 月 18 日生效，主体网络安全要求 2027 年 12 月生效。韩国 2027 年预算中半导体预算由 1.3 万亿韩元增至 3.4 万亿韩元，半导体生产基础设施由 2,000 亿韩元增至 2 万亿韩元，并新设总规模 2.6 万亿韩元的半导体特别会计。

六、重点企业动态

企业	本周事件	关键数字	市场反应
Intel	首席执行官称内存价格涨 5 至 7 倍、项目因缺内存延期；与 SK 海力士就在美生产存储进行探索性谈判；Panther Lake 在 18A 节点良率达 80%	内存涨 5—7 倍；18A 良率 80%	周 +5.50%
SK 海力士	与 Intel 探索在美生产存储，路径含租用俄亥俄产能或组建合资公司；随后澄清未敲定任何计划	无金额	周 +2.48%
三星电子	管理层称 2027 年供需比 2026 年更紧，产能优先给 DRAM 与高带宽存储；高盛重申买入并列入 Conviction Buy、目标价上调至 49 万韩元	目标价 49 万韩元	周 +0.58%
Micron	发布全球首款 512GB DDR5 服务器内存模组；第四财季业绩定于 9 月 30 日	512GB/模组；市场共识营收 510 亿美元	周 +4.16%
SanDisk	与铠侠计划在日本投资超过 310 亿美元、投资期至 2032 年；已上调闪存产品价格超过 10%	>310 亿美元；涨价 >10%	周 +9.70%
铠侠	考虑以美国存托股上市募资最高 100 亿美元	100 亿美元；市值约 1,830 亿美元	周 +1.00%，年内 +423.0%
NVIDIA	首席执行官称明年芯片销量将是今年两倍，公司处于供给受限状态；扩展开源量子平台	销量 2 倍	周 +1.82%，距一年高点 -5.7%
华为	发布昇腾 960 超节点与 11 颗芯片组合，覆盖计算、互连与存储	4,096 卡；8 EFLOPS；1PB HBM	带动 A 股半导体 9 月 18 日普涨

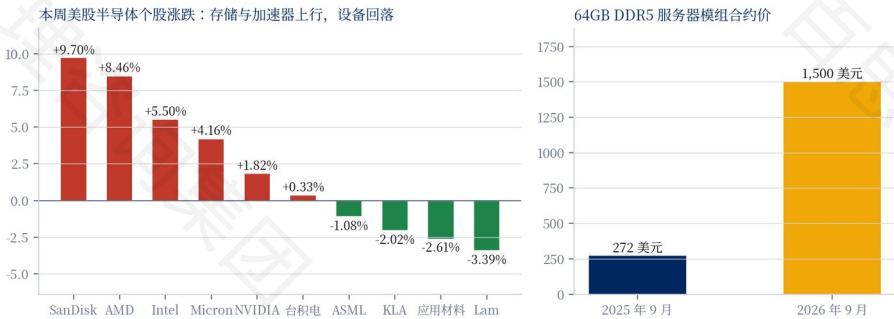


图 4 本周美股半导体个股涨跌与 64GB DDR5 服务器模组合约价变化（数据来源：Yahoo Finance、行业媒体）

七、中国半导体产业链

昇腾 960 超节点是本周中国产业链最重要的事实。单节点互联 4,096 张加速卡，为上一代 1,024 张的 4 倍 FP8 算力 8 EFLOPS，HBM 总容量 1PB；单卡规格为训练卡 FP8 稠密 2 PFLOPS、FP4 4 PFLOPS，推理卡 FP4 8 PFLOPS，HBM 288GB、带宽 9.6TB/s，互联带宽 2.2TB/s。产品时点方面，训练卡提前三个季度至 2027 年一季度就绪，推理卡提前一个季度至 2027 年三季度，2028 年与 2029 年各有一代新品。该产品的技术选择说明两点：以系统规模弥补单卡性能差距，以及以自研近封装光学降低互连功耗与器件数量——5,500 个光引擎替代约 4.8 万个 800G 光模块，系统功耗降低超 550 千瓦。其他设计企业方面，海光信息预告 9 月 22 日在深圳发布 1000 系列处理器，公司上半年营收 90.99 亿元、同比增长 66.52%，归母净利润 17.98 亿元、同比增长 49.69%，研发投入占营收 29.15%；地平线宣布征程系列累计量产突破 1,500 万套，2026 年上半年中国全阶智能驾驶芯片市占 31.94% 居首。

资本市场层面，9 月 18 日两市成交 20,771 亿元，涨停 79 家、跌停 1 家；行业口径涨幅为半导体设备 4.83%、数字芯片设计 4.68%、集成电路制造 4.59%、分立器件 4.46%、封测 4.43%、模拟芯片设计 4.42%；主力资金方面芯片概念净流入 362 亿元、存储芯片 188 亿元、数据中心 186 亿元，包揽全市场前三，全周电子行业获主力资金净流入 140.09 亿元居申万一级行业首位。个股方面，北方华创周涨 8.28%、拓荆科技涨 15.97%、中科飞测涨 26.81%、中微公司涨 6.39%、寒武纪涨 7.03%、华虹公司涨 6.82%、中芯国际 A 股涨 3.91%、海光信息涨 4.54%；封测板块华天科技 9 月 18 日涨停、长电科技周涨 7.76%、甬矽电子周涨 12.62%。一级市场方面，粤芯半导体创业板发行安排公布，9 月 18 日初步询价 9 月 24 日申购，拟募资 75 亿元；信诺维 9 月 16 日科创板上市，发行价 27.60 元、发行市盈率 59.34 倍，首日收涨 45.58%；华卓精科披露科创板首轮审核问询函回复、拟募资约 35 亿元。本周半导体公司公告以再融资与重组为主，无定增预案或回购新方案。

关于国产光刻机的流传说，本刊的判断是：本周窗口内无任何来自设备企业、晶圆厂或产业主管方面的官方光刻机进展披露，流传的原型机出光、试产与吞吐量等说法均为单一自媒体链路，其中每小时 250 片晶圆的吞吐量已接近成熟量产机型水平、工程上不具合理性。作为对照的可核实事实有三条：ASML 2027 年极紫外产能几乎全部预定完毕、2028 年产能亦已获大量订单，2025 年全球光刻机市场份额约 95%；中国两家存储企业已从 ASML 获得充足深紫外光刻工具以支撑未来三年增长计划；光刻机双

工件台供应商本周仍在回答尚未盈利的问询。截至 9 月 20 日，国产极紫外光刻机不存在可交叉验证的公开整机进展，相关概念板块的单日涨幅应归因于板块整体因素。

八、行业会议与人物观点

本周两场会议构成产业信息的主要来源。印度 Semicon India 2026 于 9 月 17 日至 19 日在新德里举行，推出第二阶段半导体方案并公布 12 个已批项目与 41 项新签合同，应用材料在会上公布至 2035 年在印度投资 50 亿美元的计划，Tata Electronics 与 Nexperia、Besi 分别签署制造与先进封装合作。华为全联接大会 2026 同期在上海举行，发布昇腾 960 超节点与 11 颗芯片组合，覆盖计算、互连与存储，同时发布鲲鹏超节点与人工智能记忆存储产品。未来两周值得跟踪的会议包括：9 月 22 日海光信息新品发布会与全球存储器行业创新峰会、9 月 22 日至 24 日云栖大会 2026、9 月 23 日骁龙峰会与台积电北美开放创新平台论坛、9 月 30 日 Micron 第四财季业绩与 Synopsys 投资者日、10 月 12 日至 15 日开放计算项目全球峰会、10 月 13 日至 15 日 SEMICON West 2026。

企业高管本周的表态集中在同一主题：需求未见拐点，约束在供给端，而存储是供给端最紧的一环。Intel 首席执行官 9 月 15 日表示："去年初我说内存可能成为大瓶颈时，没多少人意识到。它真的发生了，而且情况会更糟。"他同时表示许多项目因拿不到内存而延期，内存价格已上涨 5 至 7 倍。英伟达首席执行官 9 月 15 日在旧金山表示："安全是工程问题，不是法律问题。我们归根到底是在开发软件。"9 月 17 日他表示明年公司芯片销量将是今年的两倍，公司首席财务官表示公司当前处于供给受限状态、若无供给约束营收可翻倍。Broadcom 首席执行官本周表示需求已超过公司 1,150 亿美元的人工智能收入预测，该目标未因放缓论改变；Arm 首席执行官表示最新人工智能处理器需求处于纪录水平，供应链复杂度为主要约束；Lam Research 表示芯片需求根本上已售罄。机构研究方面，韩国进出口银行海外经济研究所 9 月 20 日将 2026 年全球半导体市场规模预测由一个季度前的 1 万亿美元上调至 1.6 万亿美元，2030 年展望上调至 2 万亿美元，存储占比由约 30% 升至 55%，并将全球九大超大规模云厂商今年资本开支增速由 80% 上调至 98%；CSIS 本周指出 2nm 芯片设计成本约 7.25 亿美元、28nm 约 4,800 万美元，先进芯片开发已超出多数公司承受能力；麦肯锡指出推理负载已占人工智能算力约三分之二，到 2030 年美国半导体人才缺口最高 15.7 万人。

九、趋势判断

- **存储紧张在 2027 年内不会自行缓解。** 前提是高带宽存储对晶圆产能的挤占系数在 HBM4 世代继续上升、主要厂商扩产投入周期设定在 2028 年至 2032 年、传统 DRAM 供给退出不可逆。反向情形：云厂商资本开支实际下调超过 15%，或四季度合约价指引涨幅低于 5%。
- **存储成本将在 2027 年上半年传导至终端售价。** 苹果已接受 2027 年一季度涨价 30%—40%，其他终端厂商的采购谈判通常滞后一个季度。反向情形：主要终端厂商在四季度公开宣布维持既有售价并自行吸收成本。
- **设备需求在 2027 年维持高位，2028 年增速回落。** 前提是 ASML 订单排满至 2027 年、台积电资本开支 600 亿—640 亿美元中 70%—80% 投向先进制程。反向情形：设备企业四季度财报将滚动需求预测的口径由八个季度收窄至四个季度。
- **先进封装瓶颈在 2028 年前后缓解，2027 年仍为加速器出货的上限约束。** 前提是 CoWoS 由 2026 年底约 13 万片/月翻倍至 2028 年底 26 万片/月。反向情形：2027 年中实际产能低于 18 万片/月。
- **半导体关税第二阶段在四季度公布的概率高于推迟至 2027 年。** 前提是先进制造投资税收抵免的开工截止日为 2026 年 12 月 31 日，两项政策存在设计关联。反向情形：11 月底前仍无相关正式文本。
- **11 月 9 日至 10 日为四季度规则风险最集中的时点。** 关税休战、关联方认定规则暂停期与关键矿产管制暂停期三项时限在同一窗口内到期。反向情形：三项中任意两项在 10 月底前获得延期安排。
- **国产加速器在 2027 年的实际出货受存储配额而非设计能力约束。** 前提是国产加速器报价已因高带宽存储成本上涨 20%—50%，且缺少与存储厂商的长期协议。反向情形：国内高带宽存储量产规模在 2027 年上半年达到可支撑十万卡级集群的水平。

十、主要风险与下周关注事项

风险	当前状况	影响对象与影响方式	观察指标
存储供给约束	64GB DDR5 服务器模组合约价为上年同	服务器整机厂商交付周期延长；中小客户被优先级排	四季度合约价指引；云厂商资本开支是否下调超过 15%

风险	当前状况	影响对象与影响方式	观察指标
	期 5.5 倍，系统厂商项目延期	挤；加速器发布时点受配额约束	
设备资本开支增速回落	设备三家距 6 月高点回撤 33%—41%，深于费城半导体指数的 18.5%	设备与零部件企业 2028 年订单与产能规划；材料企业的客户扩产节奏	四季度财报中滚动需求预测的期间长度与 2028 年金额
先进封装产能不足	CoWoS 2026 年底约 13 万片/月，2028 年底 26 万片/月	加速器出货量上限由封装而非晶圆决定	2027 年中实际产能是否达到 18 万片/月
规则时限集中到期	关税休战、关联方认定规则暂停期与关键矿产管制暂停期集中于 11 月 9 日至 10 日	跨境供应链成本与设备获取安排；企业四季度备货与合规准备	三项各自的延期或恢复安排
关税第二阶段未定	税率、产品清单、投资门槛与生效日均未公布	美国本土建厂决策与进口成本测算无法定量	正式文本的公布时点与投资门槛设计
数据中心电力接入	2026 年全球数据中心用电需求 161GW、同比 +31%，2028 年电网缺口扩大	算力部署时点由电力接入而非芯片供给决定	800V 高压直流与液冷方案的规范发布进度

日期	事件	关注要点	需要修正本期判断的情形
9 月 22 日	海光信息 1000 系列处理器发布	规格、目标场景、量产时点与定价	若明确面向端侧且量产在 2027 年之后，关于国产处理器产品线扩展节奏的判断需放缓
9 月 22—24 日	云栖大会 2026	云厂商自研算力平台的客户规模与 2027 年部署计划	若披露的国产加速器部署规模低于十万卡级，关于国产出货受存储配额约束的判断需改为受需求约束
9 月 22 日	全球存储器行业创新峰会	国内存储厂商对四季度合约价与 2027 年产能的表述	若国内厂商给出四季度价格持平或回落的预期，关于存储紧张延续的判断需修正
9 月 24 日	欧盟竞争力理事会政策辩	第二阶段芯片法案的专项资金规模与	若提出新增专项资金规模超过 100

日期	事件	关注要点	需要修正本期判断的情形
	论	优先方向	亿欧元，关于欧盟本周无实质动作的判断需修正
9月30日	Micron 第四财季业绩与指引	四季度 DRAM 与 NAND 合约价指引；高带宽存储产能与定价	若四季度合约价指引涨幅低于 5%，关于存储紧张延续至 2027 年的判断需修正
9月30日	Synopsys 投资者日	电子设计自动化在定制芯片项目中的份额与单项目价值	若定制芯片项目数量同比增速低于 30%，关于定制芯片份额上升的节奏判断需放缓
10月12—15日	开放计算项目全球峰会	800V 高压直流与液冷方案的规范进展	若 800V 规范未如期发布，关于数据中心供电约束缓解的判断需推迟
10月13—15日	SEMICON West 2026	设备企业对 2027 至 2028 年资本开支的口径与订单可见度期间	若滚动需求预测期间由八个季度收窄至四个季度，关于设备需求 2027 年维持高位的判断需下调
11月9—10日	三项规则时限同期到期	各自的延期或恢复安排	若三项中两项以上恢复原状，需重估跨境供应链成本
12月31日	先进制造投资税收抵免开工截止	四季度美国本土晶圆厂开工公告密度	若四季度开工公告数量低于三季度，关于赶末班车效应的判断需修正

十一、管理观察与行动建议

对芯片设计与系统企业而言，本周 Intel 首席执行官公开表示多个项目因拿不到内存而延期，这是存储约束从财务指标进入运营指标的标志。设计与系统企业应把存储采购从采购部门的成本议题提升为经营层的产能议题：在 2027 年产品规划中把存储可得量作为出货量上限的输入变量，而非按设计产能倒推；在四季度之前完成与存储厂商的长期供应协议磋商，接受更长的锁价期以换取配额确定性，参照苹果接受 2027 年一季度上涨 30%—40% 的做法；并对现有产品线按存储密度重新排序，优先保障单位存储产出收入最高的型号。

对制造、存储与封测企业而言，三星管理层表示 2027 年供需将比 2026 年更紧、产能扩张优先给 DRAM 与高带宽存储，而铠侠与 SanDisk 的日本投资期设定至 2032 年，这一组合说明本轮扩产按长周期安排，

短期内不会自我瓦解。存储企业应在高价格窗口内完成两件事：利用估值窗口融资，参照铠侠考虑以美国存托股募资最高 100 亿美元的做法；以及将产能承诺转化为长约收入，降低 2028 年新增产能投放后的价格下行风险。封测企业方面，CoWoS 产能 2028 年底翻倍至 26 万片/月，国内四家上半年已合计投资先进封装 274.2 亿元，投资重点应放在能够承接溢出订单的通用先进封装平台，而非绑定单一客户的专用产线。

对设备与材料企业而言，本周设备企业公开表态与股价方向相反：ASML 称订单排满至 2027 年、Lam Research 称需求已售罄、日本制设备 8 月销售同比增长 47.4%，而美系三家本周下跌且距高点回撤 33%—41%。这一背离的根源是市场对 2028 年增速的分歧，设备企业应主动改善订单可见度的披露口径，在四季度财报中给出 2028 年的订单结构而非仅给总量，并区分存储与逻辑的订单占比。材料企业方面，本周中国高纯石英通过 300mm 动态随机存储器产线验证、富士胶片在印度投资建厂、住友化学利用亚利桑那产能开发光子晶圆，本地化认证正在成为订单前提，应把认证周期而非价格作为客户开发的首要变量。

对中国产业链企业而言，昇腾 960 超节点以 5,500 个自研光引擎替代约 4.8 万个 800G 光模块、系统功耗降低超 550 千瓦，这一替换比说明国产系统方案的价值正从单芯片转向互连架构。光模块与光引擎供应商应评估近封装光学路线对既有产品的替代速度，不宜按可插拔光模块的线性增长安排产能；加速器企业应把高带宽存储的长期供应协议作为 2027 年产品发布的前置条件，当前报价已因存储成本上涨 20%—50%，若无配额保障则发布时点不具确定性。在光刻机议题上，本周无任何可交叉验证的国产极紫外整机进展，企业在对外沟通与投资决策中不应把未经确认的说法纳入技术路线假设。

对政策研究者而言，本周规则层面连续第二周空窗，但 11 月 9 日至 10 日有三项时限集中到期，四季度风险是后移而非消失。跟踪重点应放在三处：半导体关税第二阶段的税率结构与投资门槛，其与先进制造投资税收抵免 12 月 31 日开工截止日可能存在设计关联；技术管制与经贸谈判已分轨推进，不应以经贸进展推断管制松动；印度第二阶段方案拨款 135 亿美元且已有 5 个项目商业量产，封测产能的地理分流已从规划进入执行，需重新评估中国封测在 2028 年全球份额的基准假设。

对上市公司与资本市场研究者而言，本周两地半导体资产背离明显，费城半导体指数周涨 0.83%，科创 50 周涨 6.39%、半导体 ETF 周涨 8.44%，研究中应避免以统一口径描述全球半导体板块。具体建议有三条：把距一年高点回撤幅度纳入板块内部比较，设备三家回撤 33%—41%、费城半导体指数 18.5%、台

积电 2.0%，差异本身即是对不同环节增速预期的定价；对存储标的的估值应区分价格弹性与产能弹性，当前上涨主要来自前者，2028 年新增产能投放后估值逻辑将切换；对 9 月 14 日的单日回调应定性为情绪冲击，本周无任何云厂商下调资本开支，第三方机构反而将九大云厂商资本开支增速由 80% 上调至 98%。

数据来源与口径

涨跌幅统一为 2026 年 9 月 11 日收盘至 9 月 18 日收盘，复权调整仅适用于已发生拆股的标的，不作汇率换算。金额单位：美元用亿美元与万亿美元，人民币用亿元，韩元用万亿韩元与万韩元，日元用亿日元与万亿日元，新台币用亿新台币，卢比用万亿卢比。可信度分三档：高为原文、官方或交易所公告，中高为权威行业媒体转述，中为单一媒体且未获当事方确认。本期数据来自 SIA、SEMI、日本半导体制造装置协会、韩国关税厅、台湾财政部、中国进出口统计、Omdia、Gartner、TrendForce、Counterpoint、CSIS、麦肯锡、韩国进出口银行海外经济研究所与高盛的公开发布，企业数据来自台积电、Micron、英伟达、ASML、英飞凌、安森美、格罗方德、Marvell、Cadence、华为的公开公告与新闻稿以及巨潮资讯网，行情数据来自 Yahoo Finance 与腾讯行情接口，政策信息来自联邦公报、欧盟理事会文件库与各方公开发布的规划与公告。需要提示的是：SIA 月度数据为三个月移动平均口径且会修订前值；现货报价页面给出的是单日变动而非周变动；日本制装置销售为日本厂商全球销售含出口，与设备统计中的日本地区买入额是不同统计；台积电月营收为新台币合并口径。本期未能核实的信息包括半导体关税第二阶段的税率与生效日、高带宽存储单颗价格的第三方估算、台积电 2027 年产能与先进封装扩产的供应链口径数字、中国 8 月集成电路进口绝对金额，以及国产极紫外光刻机的全部流传说，上述内容均未进入本期判断句。

本报告由百思特变革研究院半导体智库基于公开信息编制，数据截至 2026-09-22。报告内容仅供行业研究参考，不构成任何投资建议，不代表任何政府机构或监管部门的立场；所涉政策信息均来自公开发布的法规、公告与新闻报道；引用请注明出处。